

产品特点:

K-5236导热凝胶是一种高性能导热凝胶,它以硅胶为基体,填充以多种高性能陶瓷粉末制成,具有导热系数高、热阻低,在散热部件上帖服性良好,绝缘,可自动填补空隙,最大限度的增加有限接触面积,可以压缩的特点。

用途:

导热凝胶广泛地应用于 LED 芯片、通信设备、手机 CPU、内存模块、IGBT 及其它功率模块、功率半导体等通讯行业、汽车行业及无人机自动化组装领域。

技术性能:

性能名称	测试值	备注
颜色	粉色	目测
挤出速度 (30cc 针管、气压 0.6Mpa, g/min)	5~15	
比重 (g/cm ³)	3.2~3.4	GB/T13354-92
最小界面厚度 (mm)	≤0.15	
使用温度 (°C)	-50~150	
击穿电压强度 (kv/mm)	≥4	GB1695-2005
体积电阻率 (Ω .cm)	≥1.0×10 ¹¹	GB/T1692-2008
导热系数 (w/m k)	6.0±0.6	ASTM D5470
阻燃等级	V-0	UL94
存放时间 (月)	12	

使用方法:

使用方便,用自动点胶机点胶。

注意事项:

导热凝胶不同于粘接胶,其粘接力较弱,不能用于固定散热装置。

包装规格:

针筒 30cc、55cc、300cc,也可以根据客户要求定制包装。

贮存: 贮存于 30°C 以下阴凉干燥处,贮存期为 12 个月。

说明:以上数据是依据我们广泛实验所得,结果是可靠的。但由于实际应用的多样性,应用条件不是我们所能控制,所以用户在使用前需进行试验以确认本品是否适用。我公司不承担特定条件下使用我公司产品出现的问题,不承担任何直接、间接或意外损失的责任。用户在使用过程中遇到什么问题,可以和我公司技术服务部联系,我们将竭力为您提供尽可能的帮助。